

有铅抗氧化还原剂 TESA

产品名称	有铅抗氧化还原剂 TESA
公司名称	苏州高新区赛格电子市场中泰电子材料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:TESA 型号:TESA-H808 规格:1000G
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路588号赛格电子市场2A42;工厂地址：苏州工业园区唯亭西区唯文
联系电话	86 0512 88600759/68051028 13656202619

产品详情

品牌	TESA	型号	TESA-H808
规格	1000G	用途	还原剂
生产能力	1000kg	产品别名	锡渣还原剂

一、产品介绍：

在波峰焊及手浸焊接工艺中，熔融的金属合金焊料（snpb、snagcu、sncu、sncuni，snagcuni等等）在250左右的高温下长期使用，由于受空气中氧气的作用，在焊料表面会产生不熔的氧化物，即我们常说的锡渣。大量锡渣的产生对焊接工艺极为不利，浪费大量的焊料、人力、物力和时间，增加了不必要的生产成本，更为严重的是降低熔锡的流动性和可焊性，使焊点质量变差，导电性和机械强度变差，影响产品品质，锡槽中的锡渣太多会阻塞炉胆，使波峰不平，影响焊接效果，甚至造成熔锡漫上pcba，造成pcb“潜水”，损坏元器件或熔锡流到炉外，造成事故。

故对锡渣量控制的程度成为波峰焊工艺的一个关键，tesa-h808,tesa-h908抗氧化还原粉专门为解决锡渣的问题而设计，比一般厂家的同类型产品效果好30%以上。tesa-h808,tesa-h908抗氧化还原粉性能稳定，可以承受高达270 ~ 350 的浸锡温度，可大幅度减少有铅、无铅锡渣量，真正降低客户焊料的成本。我们的抗氧化还原粉溶于熔锡表面，形成一层银白色的保护膜，使熔锡与空气隔绝，最大限度减少氧化的发生且兼有润滑剂作用，增加熔锡的流动性，提供其润滑能力和可焊性，从而改变焊接品质。

二、二、技术参数：

名称/规格参数/解答外观无色结晶或淡灰色粉末密度（25 ） 1.9 ± 0.02 比重约2.3ph值不适用极限值约400
闪火点不燃蒸汽压无比重（20 ） 2.1 ± 0.01 气味限度无溶释性与水完全互溶再生性无禁忌物碱，强氧化剂进行生物降解分解是残留物（高温玻璃升温350 ）高温玻璃表面无残留

三、特点：

可降低焊料成本60% ~ 90%

不占空间，投资小，经济效益高

连贯性工艺流程，无须其它耗能

可降低清锡渣频率次数80%

完全符合（rohs）指令2002/95/ec

能源有效的综合利用：

四四、优点：

在焊接时有良好的流动性

极好的焊角，平滑的焊接表面及全熔透性能

焊料熔化表面的残渣极少

增强焊接强度效果

无味、无烟、无毒

良好的耐热性，改善润湿性和扩散性